

# ECOREL™ SINTEC

## 新一代烧结解决方案

### 应用领域

在对热导率、电导率、可靠性和机械强度要求较高的应用中，烧结解决方案可替代锡膏。

首选烧结技术的一些关键领域包括无铅芯片黏贴、大面积模块黏贴、电动汽车、可再生能源转换、光电子和射频功率器件。

特别是随着最新 SiC 和 GaN 技术的发展，运行功率大大提高，使用热导率更高和导电性更出色的烧结互连技术至关重要。

### 额外优势

- 使用现有设备进行加工
- 高度重复性和可靠性
- 电阻率低 (3  $\mu\Omega\cdot\text{cm}$ )
- 不含 CMR 物质、卤素和纳米颗粒
- 符合 RoHS 标准
- 功率模块寿命提高十倍
- 全球产品供应和技术支持

## 主要特点

1

### 导热性高

ECOREL™ SINTEC 烧结解决方案的导热系数超过 300 W/mK，具有优异的散热性能，是大功率应用的理想选择。

2

### 剪切强度高

剪切强度超过 50 MPa，形成了坚固的互连，使组件能够轻松承受从 -55°C 到 +125°C 的热循环测试 (TCT) 超过 1000 次循环。

3

### 室温储存

大多数烧结膏都需要冷藏或冷冻保存，但我们的烧结膏可以在室温下保存，因此更易于操作，同时还能提供 6 个月的保质期。

4

### 不含纳米颗粒

与市场上的其他烧结解决方案不同，ECOREL™ SINTEC 产品不含纳米颗粒，对用户和环境都更安全。

### 联系我们

Inventec Performance Chemicals HQ  
26, Rue des coulons, 94363 Bry sur  
Marne (Paris), France

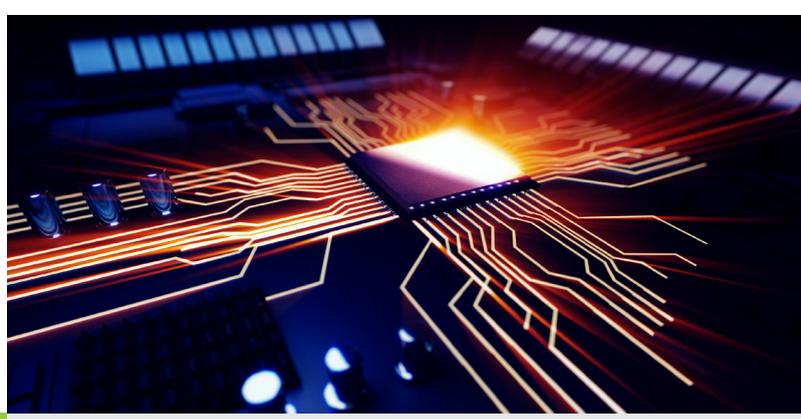
Subsidiaries:  
Spain, Switzerland, Germany, Hungary  
China, Malaysia, Japan, Taiwan, POC, USA,  
Mexico

www.inventec.dehon.com  
contact@inventec.dehon.com  
+33 (0)1 43 98 75 00

WEBSITE



电子组装的未来，突破当今的限制



一体化烧结工艺  
模具烧结和基片烧结一步完成

一体化烧结工艺有可能大幅降低此类应用的总使用成本。理想情况下，通常需要两步完成的工艺（模具烧结和基底烧结）可变为一步完成：节省 50%的能源、耗材和时间。

ECOREL™ SINTEC AP90 表现出极大的灵活性，从小到大的表面积，而且对于在烧结和应力测试期间容易翘曲的材料堆叠也表现出极大的灵活性。

## ECOREL™ SINTEC 产品系列

压力

印刷

ECOREL™ SINTEC AP90

平床蘸涂

ECOREL™ SINTEC AP90D

### 工艺特点

- 适用于芯片和模块黏贴
- 与 Si、SiC 和 GaN 芯片烧结兼容
- 底板尺寸可大于3000mm<sup>2</sup>
- 可低压烧结
- 可实现一体式烧结
- 对铜、金、银、镍有很好的润湿性

无压

印刷

ECOREL™ SINTEC XP95

蘸涂

ECOREL™ SINTEC XP95D

### 工艺特点

- 适用于芯片贴装和光电技术
- 最大芯片尺寸可达 8x8mm
- 用于标准烘箱设备
- 对铜、金、银、镍有很好的润湿性

基于技术 **ngno-join**

**INVENTEC**  
PERFORMANCE CHEMICALS

Materials made for high reliability & sustainability

SOLDERING • CLEANING • COATING • COOLING